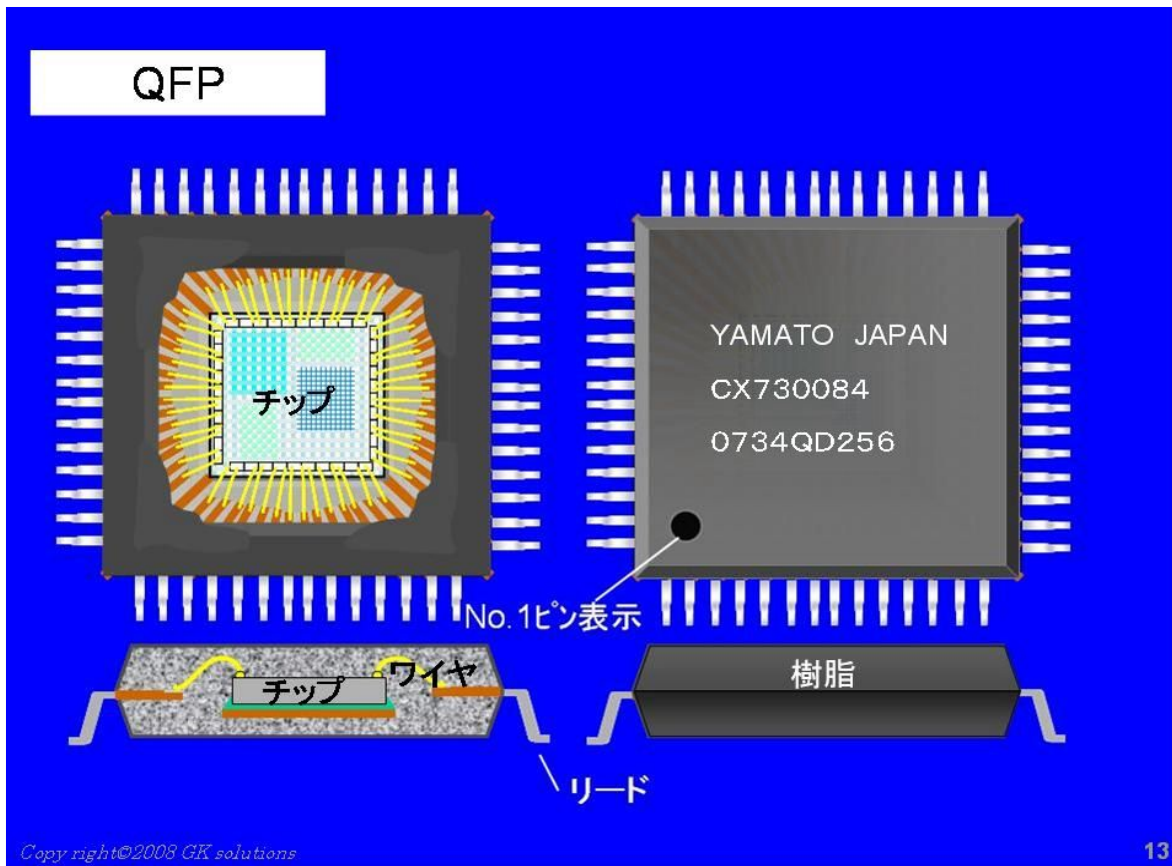


第1章-9 QFP(Quad Flat Package)

ICが大規模化LSI(Large scale integration=ラージ・スケール・インテグレイション)になると外部端子数が増大し、DIPでは対応できなくなった。また電子機器にも半導体の搭載数が増え、配線基板の両面に搭載するため表面実装型のQFPが開発された。パッケージ厚みも3~4mm程度から薄くなり1mm程度となった。



表面実装型はSMD(surface mount device=サーフェイス・マウント・デバイス)という。

技能検定 出題事例

H16 4択 第17問

・樹脂封止パッケージのQFPに関する記述として、正しいものはどれか。

- イ) Qの意味は品質を表すQualityのQのことである。
- ロ) Fは端子に用いられる鉄(Fe)合金のFである。
- ハ) Pの意味はPlasticsのPのことである。
- ニ) Fは平坦(Flat)のことである。

QFP参考図書

最先端半導体パッケージ技術のすべて
半導体新技術研究会編 村上 元監修
工業調査会:2007年9月初版
・QFP: 10,11,15,21,25,68,114頁

・QFP(Quad Flat Package)は1970年代後半に日本の半導体メーカーで開発された。

追加編集